

SAA 迅得機械股份有限公司
Symtek Automation Asia



公司介紹

成 立：1999 年10月

董 事 長：官錦堃 先生

總 經 理：王年清 先生

營運總部：桃園市中壢區

資 本 額：新台幣 6.93億

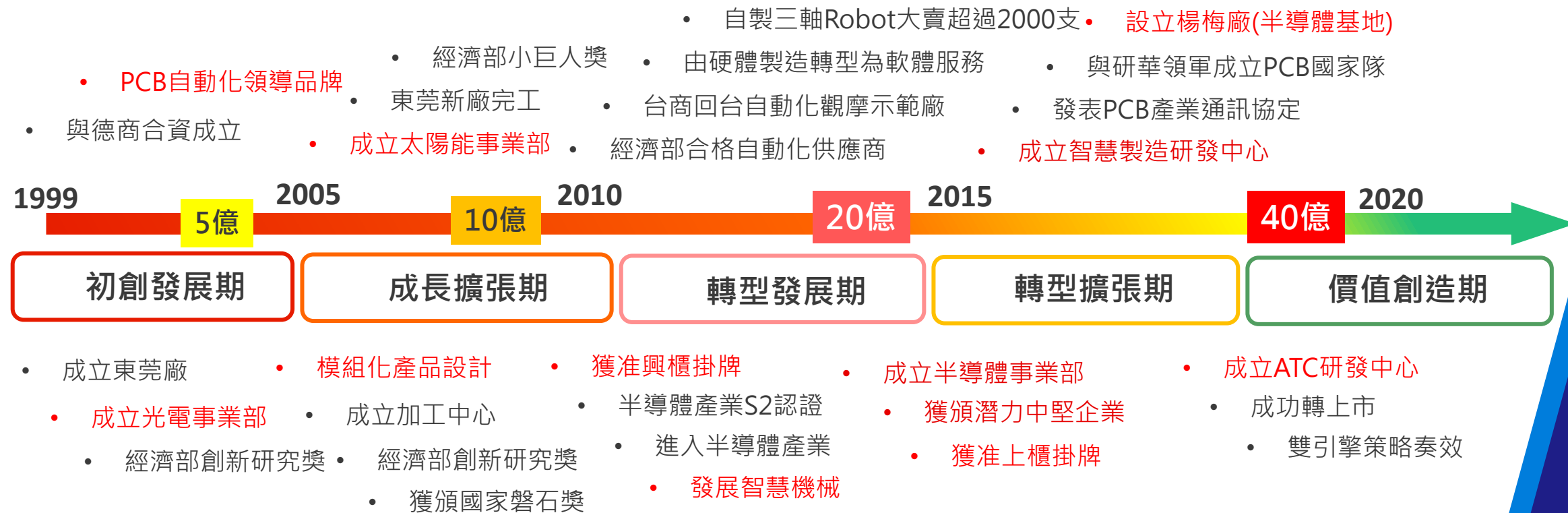
員 工 數：台灣 505人+大陸 424人

主要業務：智能自動化整合服務

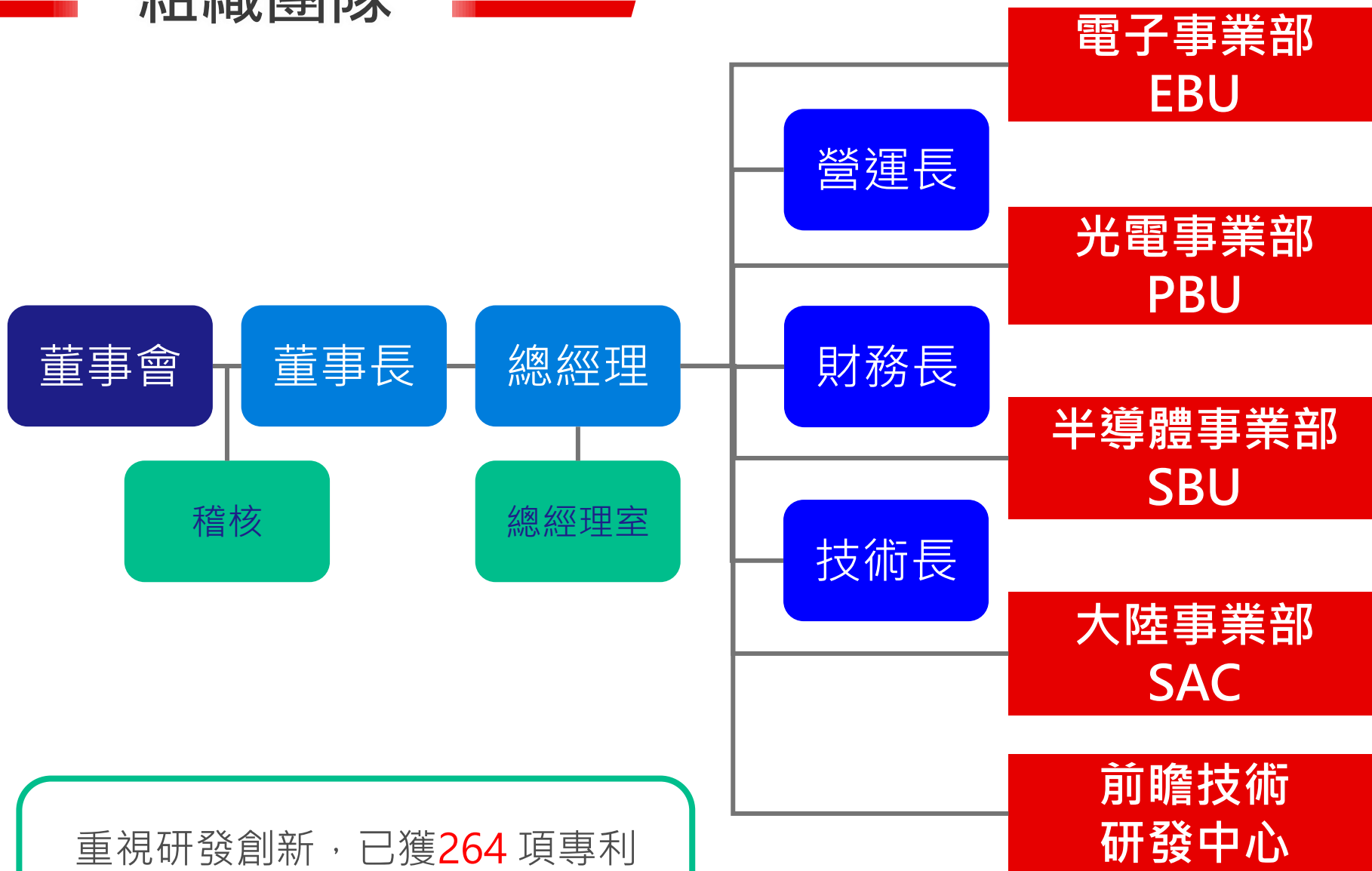
迅得機械自1999年公司成立，開拓多個產業之自動化市場，如半導體、光電產業、印刷電路板...等產業。曾榮獲：小巨人獎、國家磐石獎、創新研究獎、潛力中堅企業...等多項殊榮。並成為經濟部合格自動化供應商及自動化觀摩示範廠商。



公司沿革



組織團隊

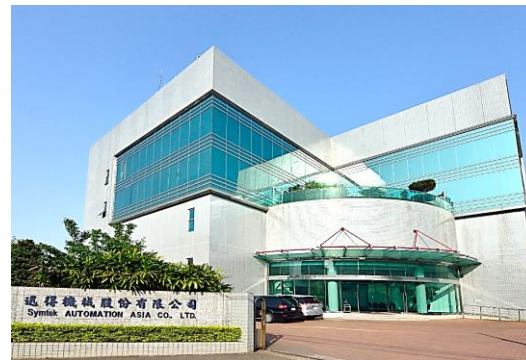


重視研發創新，已獲**264**項專利
二度榮獲創新研究獎

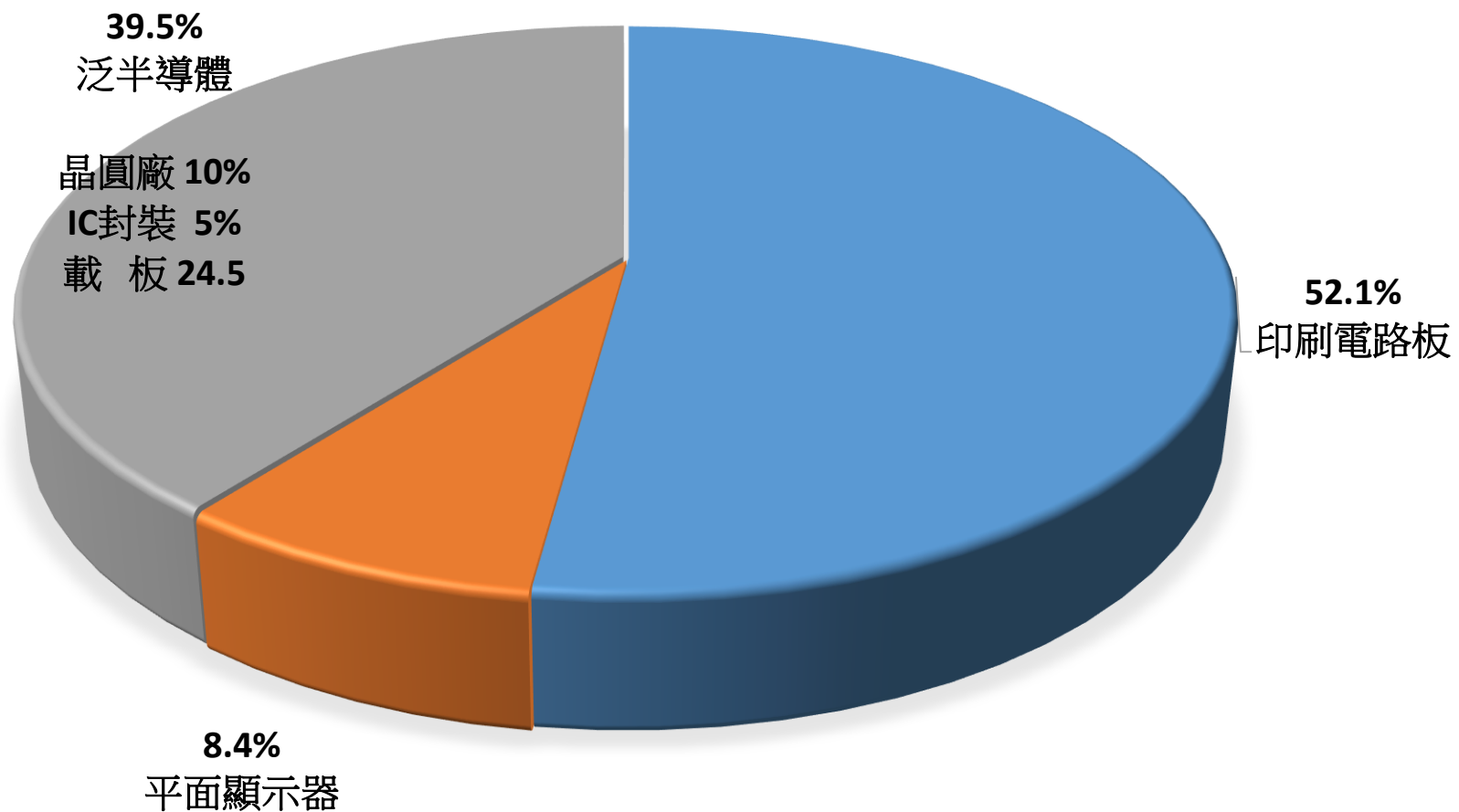
產品應用領域

事業單位	市場	產品應用	主要客戶
電子事業部	印刷電路板	自動投收板機 全廠自動化規劃整合 智慧工廠解決方案 PCB專用智慧盒	欣興、南亞、景碩 華通、台郡、嘉聯益
大陸事業部			臻鼎集團、健鼎 景旺集團、深聯
半導體事業部	半導體封裝 半導體晶圓	半導體智慧物流 半導體線上倉儲	日月光、矽品、南茂 台積電、華邦電
光電事業部	液晶面板 其他	全自動包裝機 製程自動化規劃	友達、晶技、輝能

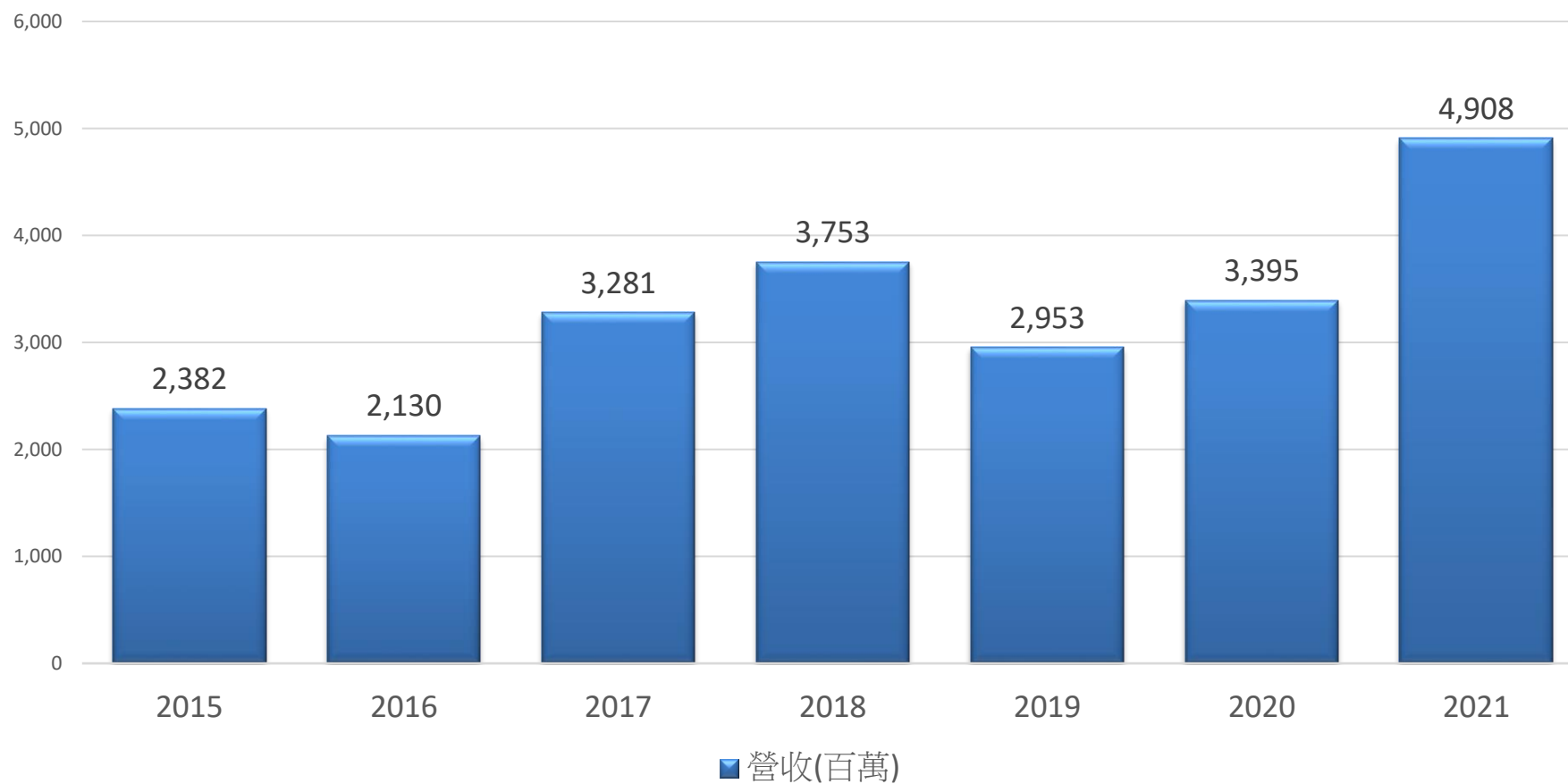
生產基地與服務據點



產品占比



SAA近年營收





PCB智慧製造系統



省人力自動化

高潔淨設備

智慧製造應用

智慧物流系統

AOI/AVI+AI 應用整合

半導體AMHS系統



8" 與 12" 晶舟搬運

先進封裝儲位搬運

智慧模組化傳送機

高潔淨RGV搬運模組

智慧化設備健康診斷

SAA華麗轉型驅動元素-PCB智慧製造



智慧生產管理決策管理



TPCA 台灣電路板協會
Taiwan Printed Circuit Association

SAA 迅得機械股份有限公司
Syntek Automation Asia



AI生產大數據加值應用



研發設計 → 內層製程 → 基板處理 → 壓合鑽孔鍍銅 → 外層製程 → 防焊製程 → 表面處理 → 檢測成型 → 出貨包裝



PCB產業智慧設備生態大聯盟



智慧分板點數包裝機



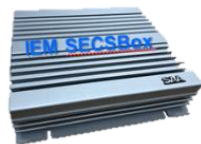
雙臂小板件整列系統



AI-ML讀碼系統



智慧分板點數包裝機

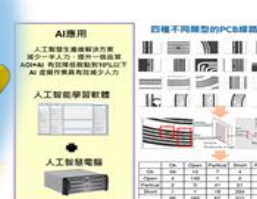


智慧搬運AGV系統



多軸機器人應用

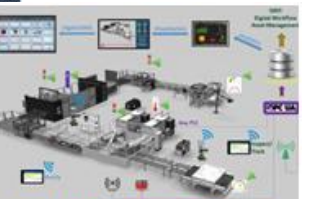
智慧自動化裝備



AI瑕疵複檢與分類系統



自動化設備IEM2.0系統



智慧物流MCS調度管理系統



自動化設備EAP控管系統



智慧WIP倉儲管理系統



智慧生產應用APPs

智慧自動化軟體

SAA在載板產品應用- 高階載板廠智能化物流解決方案

業界最完整的
智慧工廠解決方案

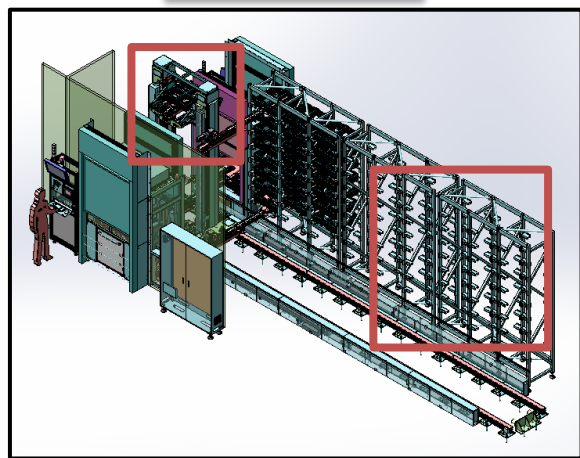


AGV無人自走車

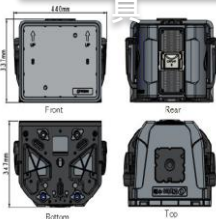
智慧製造軟體



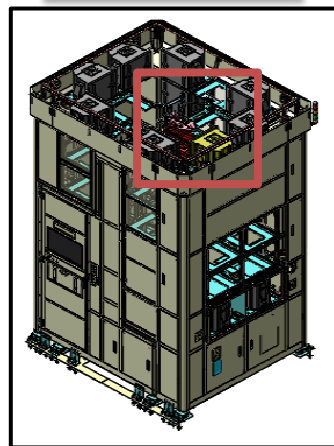
SS-803 線邊倉



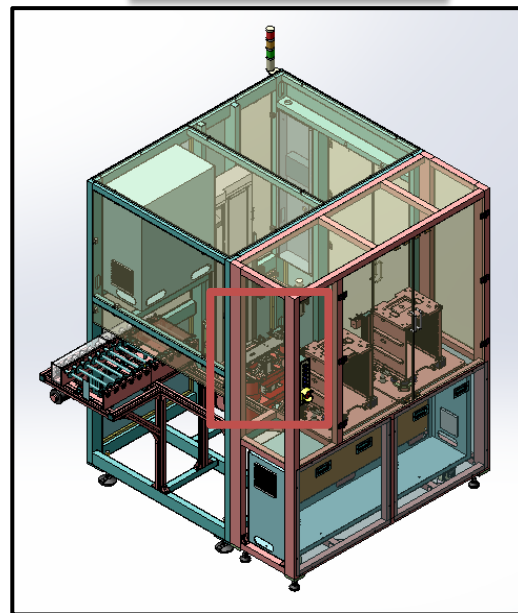
專用無塵載



ZIP示意圖



水平三軸收放板機

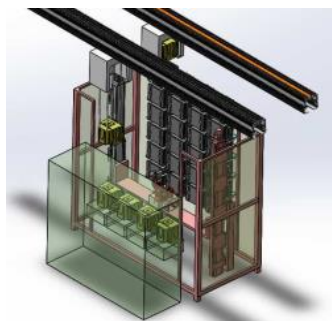


六軸收放板機

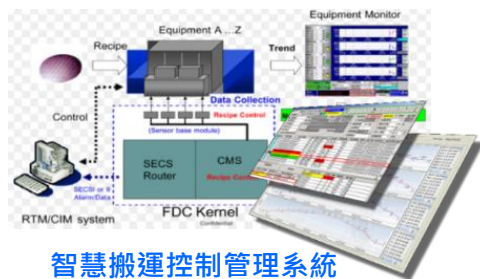


連接各式製程

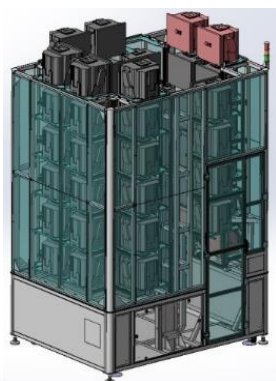
SAA華麗轉型驅動元素-半導體AMHS系統



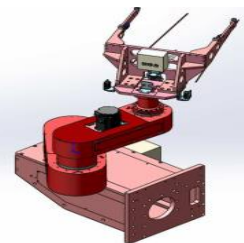
嵌入式晶舟儲位系統



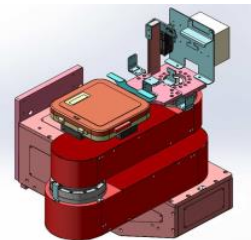
智慧搬運控制管理系統



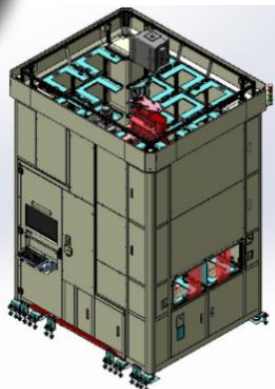
智慧12" 晶舟儲位系統



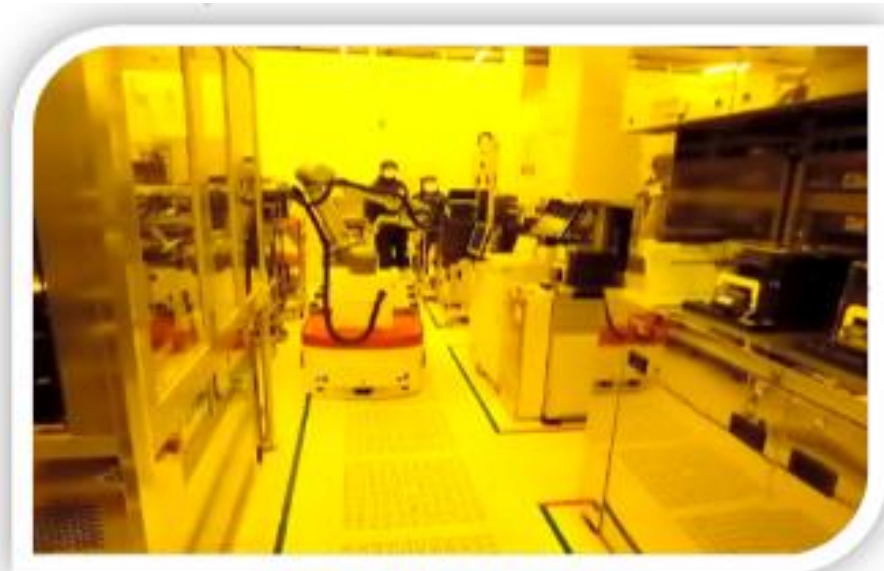
核心多功能三軸機器手



智慧半導體ZIP系統

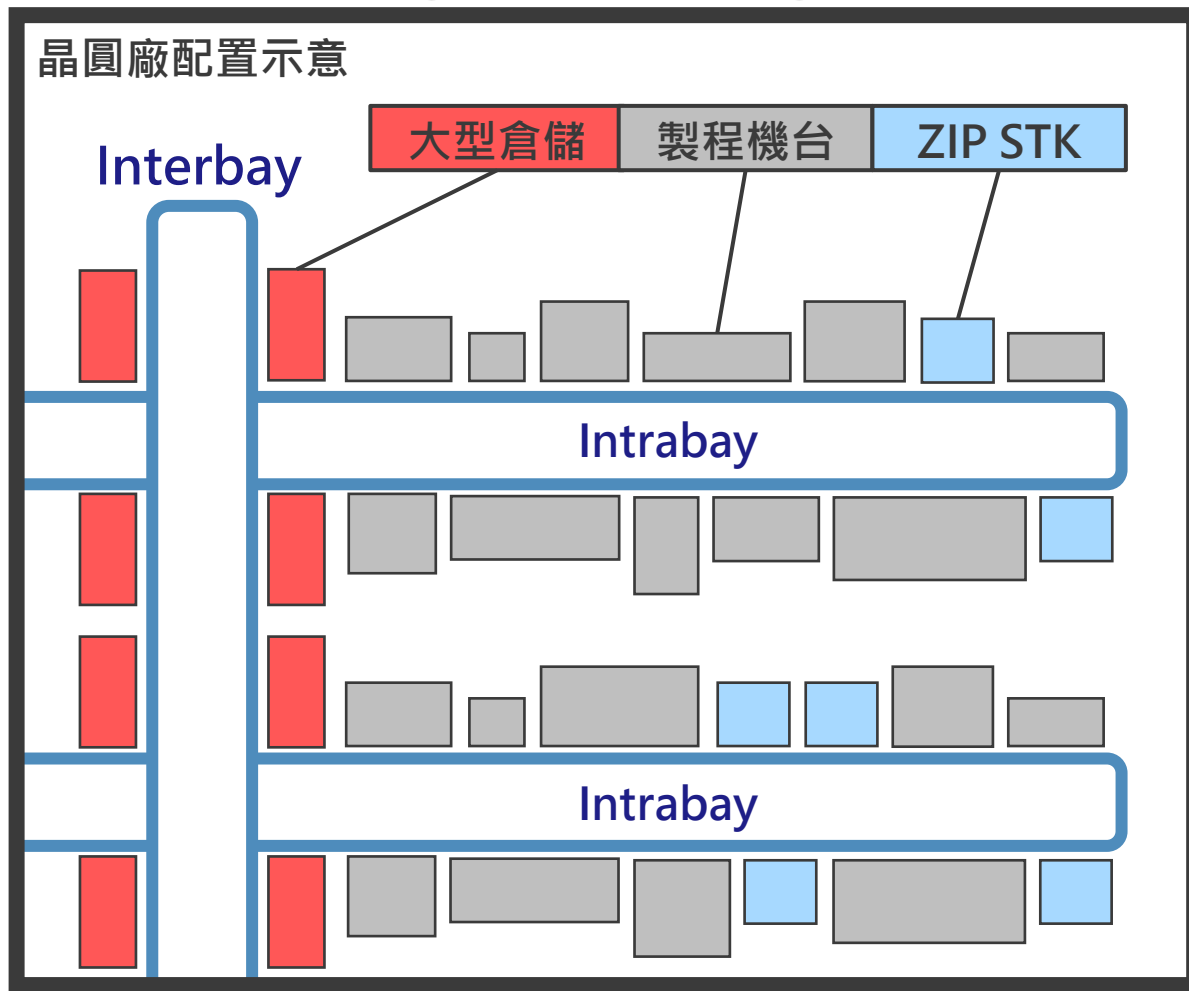


智慧8" 晶舟儲位系統



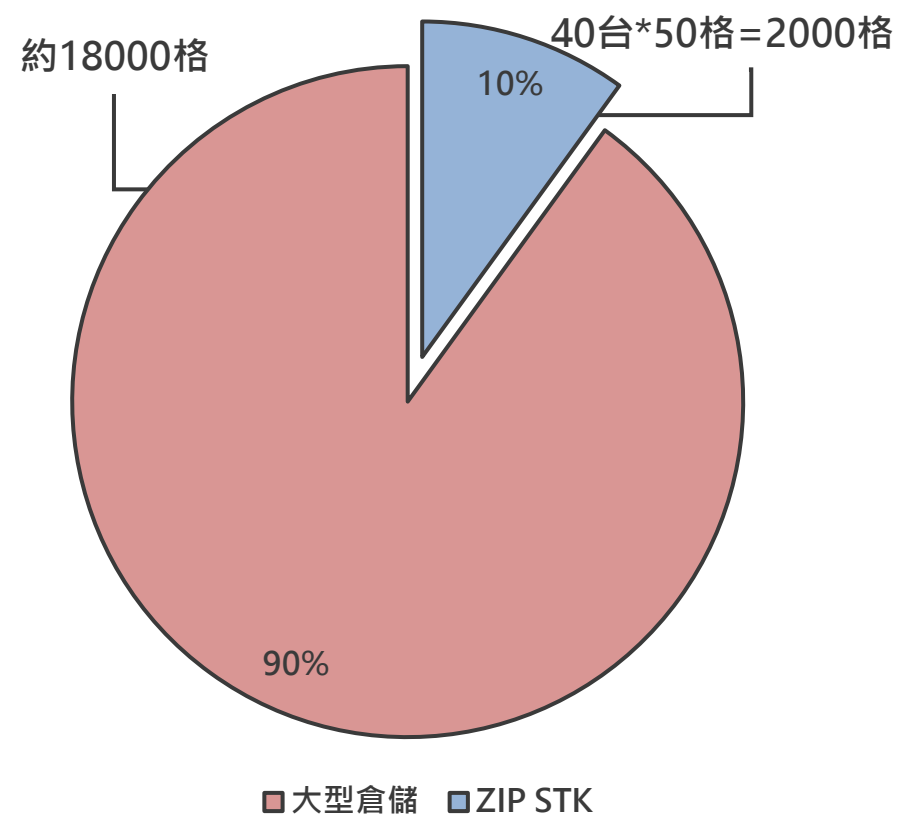
半導體廠RGV搬運實施案例視頻

Storage arrangement in Foundry



超大型晶圓廠單一Phase

儲位分配



半導體晶圓廠智能化物流解決方案

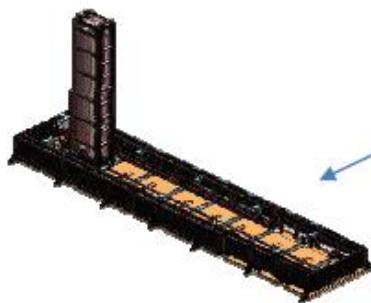


OHT 往下看
(300mm)



村田大福
智慧製造大數據去瓶頸AI運籌

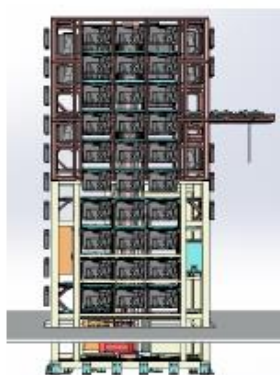
Conveyor or long port



STD FOUP & Reticle STK



FOUP & Reticle ZIP STK



FOUP & Reticle Taller ZIP STK

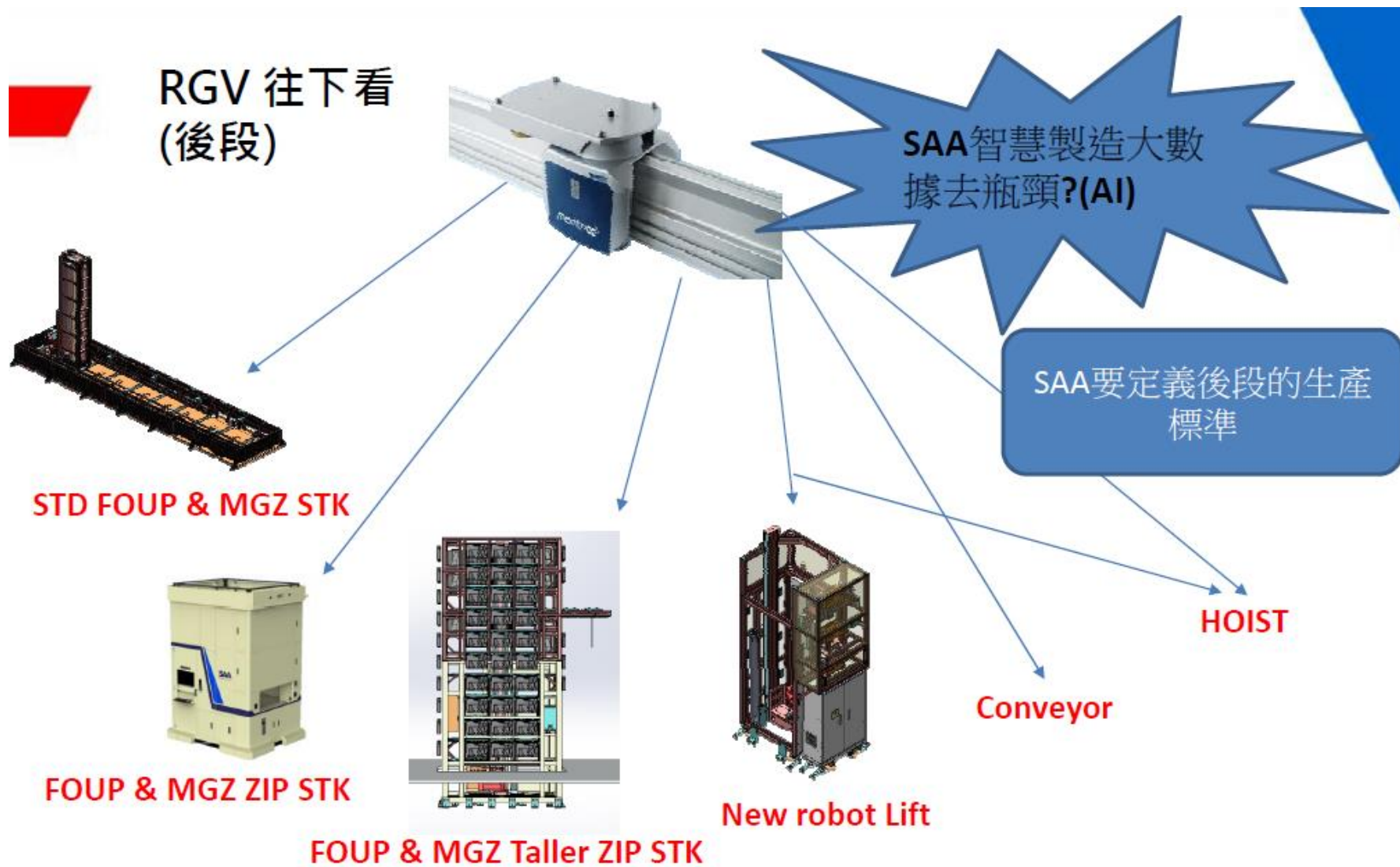


EFEM
SORTER



FOUP Exchange
FOUP NTB

半導體封裝廠智能化物流解決方案



永續經營佈局-打造半導體生產基地(新生廠)

土地: 4000坪

總建坪: 8000坪以上



1. 持續提升半導體產品營業比重
 - 配合台積電持續開發新產品
 - 拓展半導體市場新客戶
2. 提升毛利率
 - 智慧製造解決方案提升產品價值
 - 持續跟進鎖定高端載板市場與半導體先進製程
3. 發展ESG企業永續
 - 規劃綠建築節能減碳
 - 規劃淨零碳排期程目標
 - 開發更節能減碳之設備產品

簡報完畢，敬請指教



Thank you for your attention

與您攜手合作共創雙贏

SAA

Symtek Automation Asia